

CERTeM Plus

Depuis 2014, le CERTeM s'investit dans une nouvelle thématique de recherche : **connectique et packaging 3D**. Pour répondre aux nouveaux objectifs liés à cette thématique, le CERTeM a développé une nouvelle plateforme : le **CERTeM Plus**, composé de deux salles blanches et d'un **l a b o r a t o i r e** .

A travers cette thématique, le CERTeM suit l'évolution technologique des **puces électroniques** en termes de **miniaturisation** et d'**intégration** et développe dans ce cadre de nouveaux procédés dans le domaine de l'**encapsulation des composants**.

La plateforme CERTeM Plus a été conçue grâce au soutien financier de **Tour(s) Plus** et du **FEDER** et s'appuie sur les infrastructures de l'entreprise **STMicroelectronics**.

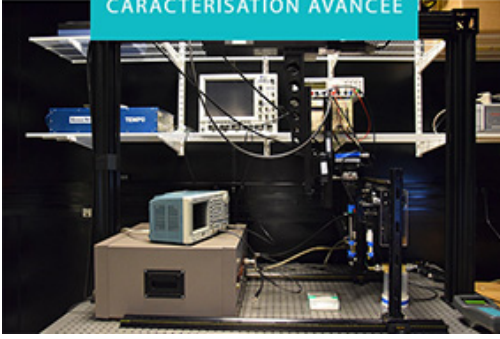


- Wire bonder
- Device bonder



- Machine de découpe de plaquettes

CARACTÉRISATION AVANCÉE



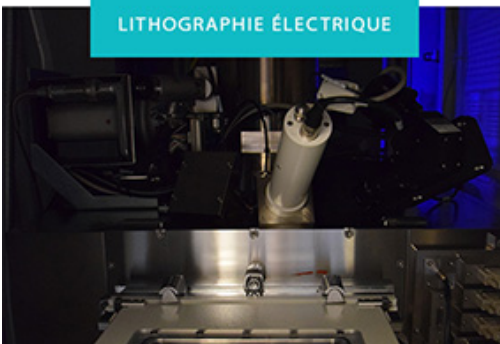
- Microscope confocal
- Microscope holographique digital
- Banc d'impédance
- Vibromètre laser
- Banc de caractérisation optique et acoustique
- Nanoscratch testeur
- Equipement de nanoindentation

DÉPÔT



- Equipement pour le dépôt de couches minces de polymère

LITHOGRAPHIE ÉLECTRIQUE



- Equipement de lithographie à faisceaux d'électrons (E-beam)

